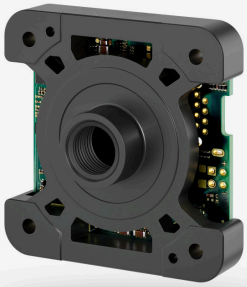
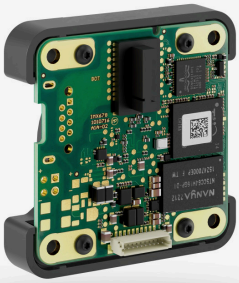
GV-53D1LE-M-MB Rev.2 (1011705)

In Serie
Das Modell ist in Serie und langfristig verfügbar.



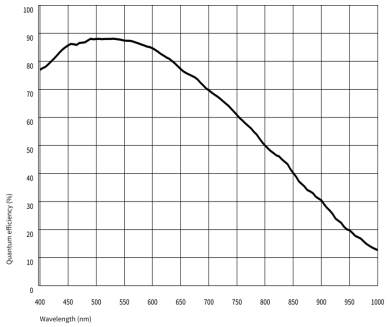




Spezifikation

Sensor

Sensortyp	CMOS Mono
Shuttersystem	Global-Shutter
Charakteristik	Linear
Auflösungsklasse	3 MP
Auflösung	3,20 MPixel
Auflösung (h x v)	2064 x 1552 Pixel
Seitenverhältnis	4:3
ADC	12 Bit
Farbtiefe (Kamera)	12 Bit
Optische Sensorklasse	1/3,1"
Optische Fläche	4,644 mm x 3,492 mm
Optische Sensordiagonale	5,81 mm 1/3,1"
Pixelgröße	2,25 µm
CRA (Chief Ray Angle)	8 °
Hersteller	Sony
Sensorbezeichnung	IMX900-AMR-C
Verstärkung (Gesamt/RGB)	16x/-
AOI horizontal	selbe Bildrate
AOI vertikal	erhöht die Bildrate
AOI Bildbreite / Schrittweite	256 / 2
AOI Bildhöhe / Schrittweite	1 / 1
AOI Positionsraster horizontal, vertikal	2 / 1
Binning horizontal	erhöht die Bildrate
Binning vertikal	erhöht die Bildrate
Binning Methode	Horizontal: Mittelwert / Vertikal: Mittelwert
Binning Faktor	2x2
Decimation (Subsampling) horizontal	-
Decimation (Subsampling) vertikal	-
Decimation (Subsampling) Methode	M/C automatisch



IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Tel +49 7134 96196-0 · E-Mail info@ids-imaging.com

GV-53D1LE-M-MB Rev.2 (1011705)

Modell

Bildrate Freerun-Modus	39 fps
Bildrate Trigger (fortlaufend)	39 fps
Bildrate Trigger (maximal)	50 fps
Belichtungszeit min - max	0,023 ms - 2000 ms
Leistungsaufnahme	2 W - 3,4 W
Bildspeicher	128 MB

HDR

Modus	QuadHDR

Umgebungsbedingungen

Für Platinenversionen beachten Sie die gesonderten Hinweise in der jeweiligen Dokumentation.

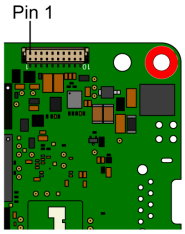
Zulässige Gerätetemperatur während des Betriebs	0 °C - 80 °C / 32 °F - 176 °F
Zulässige Umgebungstemperatur während des Betriebs	0 °C - 25 °C / 32 °F - 77 °F
Zulässige Umgebungstemperatur während der Lagerung	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
Luftfeuchtigkeit (relativ, nicht kondensierend)	20 % - 80 %

Anschlüsse

Schnittstellen-Anschluss	ZIF
I/O-Anschluss	10-poliger Würth-Steckverbinder (WR-WTB 1.00 mm)
Spannungsversorgung	12 V - 24 V

Pinbelegung I/O-Anschluss

1	Versorgungsspannung (VCC) 12-24 V
2	Stromversorgung, Masse
3	General Purpose I/O (GPIO) 2, 3,3 V - Line 3
4	General Purpose I/O (GPIO) 1, 3,3 V - Line 2
5	I2C SCL (Signal Clock) 3,3 V
6	I2C SDA (Signal Data) 3,3 V
7	Trigger-Eingang, ohne Optokoppler 3,3 V - Line 0
8	Blitz-Ausgang, ohne Optokoppler 3,3 V - Line 1
9	Masse (GND)
10	Spannungsausgang 3,3 V, max. 100 mA



Bauform

Objektivanschluss	S-Mount
Schutzart	-
Abmessungen H/B/T	50,0 mm x 50,0 mm x 23,5 mm
Gewicht	27 g
Gehäusematerial	-

Features

Liste der Bildvorverarbeitungsfunktionen direkt auf der Kamera.
Alle Funktionen der Tabelle stehen via unserer IDS peak Software zur Bildvorverarbeitung auf dem Host-Computer zur Verfügung (abhängig vom Sensormodell).

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Tel +49 7134 96196-0 · E-Mail info@ids-imaging.com

GV-53D1LE-M-MB Rev.2 (1011705)

Bilderfassung	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	-
	Denoiser	✓
	Long exposure	-
	Line scan	-
Blitz	Flashing	✓
	PWM flashing	-
Bildeinstellungen	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y
Bildverarbeitung in der Kamera	Pixel formats	Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	-
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
Andere	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	-
	Sequencer	-
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.62.25422

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Tel +49 7134 96196-0 · E-Mail info@ids-imaging.com